东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

（2026 年 11 月 3 日）

证券代码：688110　　证券简称：东芯股份

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研　☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访　☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会　☑ 路演活动 ☐ 现场参观　☐电话会议 ☑ 其他（策略会）
参与单位名称	安联资管、安信基金、北大方正人寿、比邻投资、财通基金、长城基金、长江养老、诚通基金、创金合信、淡水泉、大成基金、德邦基金、东北证券、东吴基金、东方阿尔法、东方基金、东方证券、富国基金、富安达基金、工银安盛资管、国联基金、国海富兰克林、国海证券、国金基金、国华兴益、皓峪资本、海富通、海通证券、鹤禧投资、弘毅远方、华安基金、华宝基金、华泰保兴、华泰柏瑞、华泰证券、华夏基金、合众资管、汇丰晋信、建信基金、建银国际、江信基金、金鹰基金、景林资产、交银施罗德、开源自营、长信基金、摩根士丹利基金、农银汇理、盘京投资、鹏华基金、平安基金、平安资管、浦银安盛、浦银理财、融通基金、上海非马、申万菱信、申万证券、泰石投资、太平资产、泰康基金、泰康资产、泰信基金、阳光资产、信达澳亚、兴业基金、兴业证券资管、兴全基金、兴合基金、兴银基金、新思哲投资、野村东方资管、野村证券香港、永赢基金、羿鹏投资、招商证券、招商基金、中银基金、中银资管、中邮保险资管、中信资管、中信证券、中金公司、国寿资管、广发基金、银华基金、中泰证券
活动时间	2026 年 10 月 26 日、10 月 28 日、10 月 29 日、10 月 30 日
活动地点	公司会议室、策略会、反路演
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 副总经理：潘惠忠 财务总监：孙馨 证券事务代表：黄沈幪 投资者关系：唐超宇、杨丽颖
投资者关系活动主要内	**1：如何判断利基存储价格后续走势？** 答：从供给端看，由于供给侧紧缺尚未完全缓解，海外存储原厂进一步将产能转向高利润产品线，对利基型存储产品带来产能挤压，导

容介绍	致利基型存储有效供给持续收缩，公司利基型存储产品的市场价格仍存在上涨动力。从需求端看，在 AI 浪潮引领下，网络通信、工业控制、汽车电子等下游应用需求稳步复苏。三季度利基存储市场价格持续环比上涨；展望四季度，供需缺口仍将对行业市场价格形成强支撑。不过，因各细分产品的紧缺程度存在差异，且下游客户对产品质量、稳定性等要求不尽相同，不同产品的涨价幅度和节奏也有所分化。感谢您对公司的关注。 **2：下游各领域需求和订单情况如何？** 答：公司客户主要分为网络通信、监控安防、消费电子、工业控制和汽车电子五大类。不同下游领域的需求受行业周期、产品价格及客户供应链策略等因素影响，表现有所差异。总体来说，消费电子类客户对产品价格的敏感度相对较高；工业控制、车规类客户则更加关注产品生命周期、供货稳定性及品质一致性，加之海外原厂加速退出利基市场对其供应链的影响较为明显，因此相关需求受存储产品价格波动影响相对有限。公司将持续关注各领域客户需求变化，稳步推进产品导入与市场拓展。感谢您对公司的关注。 **3：海外厂商退出利基市场给国内及中国台湾厂商带来机会，公司在 2D NAND 市场希望取得怎样的成绩？** 答：公司持续布局 SLC NAND Flash 的新制程开发及多样化产品拓展，形成了较为完整的产品矩阵和核心竞争优势。展望未来，公司将立足现有市场稳步经营，持续夯实网络通信、消费电子等基本盘，同时深化与国内外晶圆代工厂及封测厂的战略合作，保障供应链稳定与产能弹性。产品端方面，公司车规级存储布局已取得阶段性成果，SLC NAND、NOR 及 MCP 产品均通过 AEC-Q100 车规验证，成功进入国内多家整车厂白名单并在多款车型实现规模量产；工控领域市场渗透率也在稳步提升。公司在持续深耕中小容量、高可靠 SLC NAND 产品的同时，对 MLC NAND 相关方向保持关注，并结合技术积累及市场需求进行相应布局。当前海外大厂持续退出 2D NAND 市场，存储产业国产替代进程加速，公司凭借多年技术积累、完整产品矩阵及优质客户资源优势，积极把握市场机遇，持续提升产品竞争力与市场服务能力。 **4：公司的产能后续是否有进一步提升的可能性？** 答：公司采用 Fabless 经营模式，专注于芯片的研发设计与销售。公司采取“本土深度、全球广度”的供应链策略，与国内外多家知名晶圆代工厂和封测厂建立了长期稳定的战略合作关系。2026 年，在海外原厂逐步退出利基市场的背景下，公司有序加大主要存储产品线的生产与备货力度，以匹配市场需求的持续提升。公司将根据市场供需变化和客户订单情况，动态调整投片规模，并不断深化与供应商的合作关系，保障产能供应的稳定性与连续性。

	5：公司是否与客户签订长期供货协议？ 答：考虑到存储行业周期波动特征，以及下游客户对供应链稳定性和交付连续性的需求，公司结合与客户的长期合作基础、产品认证周期及国产化配套需求，已陆续推进与部分客户的长期供货协议安排及落地。如涉及达到披露标准的重大合同，公司将按照相关规则及时履行信息披露义务。 **6：三季度以来公司各类产品的涨价情况如何？** 答：三季度以来，公司各品类存储产品的市场价格走势呈现分化。DRAM 的供需缺口相对更大，短期供给端难以快速改善，价格预计维持一定上涨趋势。大容量 Flash，包括 NAND 和 NOR，由于 AI 服务器等高端场景对高可靠、大容量存储的需求持续向好，长期成长逻辑支撑价格仍有上行空间；小容量 NAND 价格基本保持平稳，小容量 NOR 市场价格承压、存在松动迹象。公司结合市场供需、产品成本及客户合作情况，动态调整产品销售策略。 **7：MLC NAND 存在较大市场缺口，公司是否计划布局？** 答：公司在持续深耕中小容量、高可靠 SLC NAND 产品的同时，对 MLC NAND 相关方向保持关注，并结合技术积累及市场需求进行相应布局。 **8：公司后续对砺算的投资规划如何？** 答：公司以存储为核心，向“存、算、联”一体化领域进行技术布局，对砺算科技的战略投资是上述布局的重要举措。公司与砺算科技保持战略与技术沟通，持续关注其经营发展，并持续支持其业务推进与技术演进。后续如涉及相关股权安排，公司将结合自身战略规划、业务发展需要及市场情况统筹考虑，并按照相关规定及时履行信息披露义务。 **9：存算联一体化融合芯片在端侧 AI 领域如何布局？目前进展如何？** 答：公司依托存储主业优势，使用约 6.82 亿元超募资金实施存算联融合芯片研发项目，拟通过先进封装技术将存储、联接、计算单元集成于单芯片，面向端侧 AI 打造低功耗嵌入式智能计算芯片，具备本地智能处理、低延迟、高数据隐私性、低功耗的特征，适配端侧 AI 持续在线的应用需求。应用端重点布局智能家居、工业物联网、医疗健康、消费电子、能源管理等端侧场景。公司相关团队在 RISC-V 架构、AI 加速、ISP 图像处理及超低功耗显示等技术方向积累了较为完整的研发能力，覆盖芯片架构定义、设计验证、封装测试及量产的全流程，并可提供软硬一体化解决方案。项目将与公司现有中小容量存储产品形成协同，推动公司向智能芯片及解决方案提供商拓展。项目规划周期约 42 个月，其中计算芯片由公司自有计算团队独立开展研发，目前正按计划有序推进，进展顺利；当前处于研发阶段，芯

	片后续还需完成架构验证、流片、软硬件调试、客户导入等环节，研发落地存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
日期	**2026年11月3日**